

公司代码：688020

公司简称：方邦股份

广州方邦电子股份有限公司
2019 年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2019 年度利润分配预案为：拟以实施权益分配股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），合计拟派发现金红利 40,000,000.00 元（含税），占公司 2019 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 31.09%，不进行资本公积金转增股本，不送红股。公司 2019 年度利润分配方案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。

7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

适用 不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股（A 股）	上海证券交易所科创板	方邦股份	688020	不适用

公司存托凭证简况

适用 不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	余伟宏	孙怡琳
办公地址	广州高新技术产业开发区开源大道11号A5栋第六层	广州高新技术产业开发区开源大道11号A5栋第六层
电话	020-82512686	020-82512686
电子信箱	dm@fbflex.com	dm@fbflex.com

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

1、主要业务

公司主营业务为高端电子材料的研发、生产及销售，专注于提供高端电子材料及应用解决方案。公司现有产品包括电磁屏蔽膜、导电胶膜、极薄挠性覆铜板及超薄铜箔等，属于高性能复合材料。其中电磁屏蔽膜是公司报告期内的主要收入来源。

2、主要产品及服务情况

(1) 电磁屏蔽膜

电磁屏蔽膜是一种电磁屏蔽材料，目前主要应用于关键电子元器件 PCB、FPC 及相关组件中，是 FPC 的重要原材料，因其优异的性能，在电磁屏蔽和吸波领域具有广阔的应用空间。

公司的电磁屏蔽膜主要可分为 HSF6000 和 HSF-USB3 两大系列。其中 HSF-USB3 系列是 2014 年推出的新型电磁屏蔽膜，具备自主研发的独特微针型结构，屏蔽效能进一步提高，同时可大幅降低信号传输损耗，降低传输信号的不完整性。公司的电磁屏蔽膜产品填补了我国在高端电磁屏蔽膜领域的空白，打破了境外企业的垄断，目前大量应用于华为、小米、OPPO、VIVO、三星等知名终端品牌产品。

(2) 极薄挠性覆铜板

挠性覆铜板（FCCL）是 FPC 的加工基材，由挠性绝缘层与金属箔构成。下游电子产品的快速发展，推动 FPC 制造技术向高性能化和轻薄化方向不断创新和突破，从而对 FPC 的高密度互

连（HDI）技术要求也不断提高。极薄挠性覆铜板是实现高密度互连技术的关键材料之一。公司使用自主核心技术生产的极薄挠性覆铜板，分为极薄三层挠性覆铜板和极薄两层挠性覆铜板，其铜层厚度、剥离强度等关键指标国际先进，具有优异的加工性能。

(3) 超薄铜箔

超薄铜箔是满足高要求印制电路板（PCB）的重要材料。公司的超薄铜箔可满足 PCB 的细线化、高密度化、薄层化的要求，同时可适应 PCB 高可靠性的要求，实现高频信号传输；还可以作为锂电池负极材料的载体，提高锂电池的能量密度。

(二) 主要经营模式

1、采购模式

公司采用“以产定购、批量订购”的采购模式，由采购人员根据各个品种需求量和生产计划时间以及库存情况，确定每个品种的订购批量并发出订货需求单。公司的采购体系执行 ISO9000 标准，采购价格确定方式主要采用询价模式。

2、生产模式

电磁屏蔽膜及导电胶膜产品的保质期为三个月，且需要冷藏储存，为减少库存及降低损耗，公司采用“以销定产、需求预测相结合”的生产模式，由市场部接到客户订单或需求后向生产部门下达生产指标，生产部门根据订单情况及产品库存情况安排相应的生产计划。

公司核心生产环节包括载体膜表面处理、绝缘层涂布、金属合金层形成、微针状金属层形成、导电胶层涂布等，公司的产品为高端电子材料，生产工艺复杂，技术含量高，为有效控制产品质量，防止技术秘密外泄，逐步形成了高度自主的生产模式，上述生产环节均由公司自主完成，不存在外协加工的业务模式。公司对生产技术和产品质量控制标准实行严格管控，在生产过程中由检验人员和检测设备对生产流程全过程进行监测，并对最终产品进行质量检验。

3、销售模式

报告期内，公司的销售模式为直销模式，直接客户为 FPC 厂商，最终用户为智能手机、平板电脑等品牌厂商，不存在经销的情形。

公司一方面根据市场调研、行业变化趋势、技术进步等情况，自行针对目标市场进行产品开发，为下游客户提出解决方案；另一方面，公司和下游 FPC 厂商以及终端品牌厂商建立了良好的

合作关系，形成了良性互动。公司根据下游客户的需求进行针对性的产品开发和销售。

产品开发完成后，由 FPC 厂商进行打样、工艺验证和基本性能测试，通过后由封装/终端品牌厂商进行整体性能测试，之后通过小批量试产，验证品质的稳定性后即可进入终端产品的物料清单。待相关方就商务条款达成一致，公司即可量产、销售。

4、研发模式

公司长期坚持自主创新，采用定制式研发和主动式研发相结合的方式。在定制式研发方面，通过与下游终端厂商的技术交流，了解下游终端厂商对电磁屏蔽膜等产品的个性化需求，进行定制式研发。在主动式研发方面，采用自主研发的设备，依靠自身积累的经验，根据市场需求，设计产品，生产部门配合研发实验室进行测试确认，不断优化实验方案，不断改进，最终确定方案进行小批量试产，试产成功后再进行大批量生产，逐步提升现有产品的性能。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1) 所处行业

公司主营业务为高端电子材料的研发、生产及销售，根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”；根据国民经济行业分类与代码（GB/T4754-2017），公司所处行业属于“C3985 电子专用材料制造”。

(2) 行业发展阶段及基本特点

电子专用材料制造行业是支撑国民经济和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业，其发展程度是一个国家科技发展水平的核心指标之一。电子专用材料行业发展不充分，将导致其下游产业如高精密线路板、芯片、半导体等战略领域须依赖进口原材料，形成“卡脖子”困境。近年来，国家颁布了一系列政策法规，将信息技术和电子专用材料制造确定为战略性新兴产业之一，大力支持其发展。2018 年颁布的《战略性新兴产业分类》，明确将“电磁波屏蔽膜”、“高频微波、高密度封装覆铜板”、“PCB 用高纯铜箔”、“高纯铜箔（用于锂电池）”等电子专用材料列为重点产品。

公司产品的直接下游客户为 FPC 厂商。近年来，随着消费电子、汽车电子和通信设备等行业的快速发展，FPC 市场规模逐年扩大，根据 PrismaMark 的统计，2017 年全球 FPC 产值为 125.2 亿

美元，同比增长 14.9%，占印制电路板总产值份额由 2016 年的 20.1% 上升至 2017 年的 21.3%。全球 FPC 产值整体呈上升趋势，增大了对公司产品的市场需求。总体来看，电子专用材料市场增长前景可观，我国电子专用材料自给率仍较低，依然具有很大的成长空间。

(3) 主要技术门槛

电子专用材料的研发及制造是一个复杂的系统工程。以公司目前主营产品电磁屏蔽膜来说，其原料配方、生产工艺、品质控制均较为复杂；下游应用给产品提出了较高的要求，除满足屏蔽效能以外，还要满足轻薄、耐弯折、高剥离强度等要求；相关产品没有通用的生产设备，生产工序未有行业标准，要生产出品质性能高、稳定性好的产品，并保证良品率，企业必须不断改进生产工艺，不断升级、改善自主研发的关键设备和原料配方。随着技术的进步，产品升级速度不断提升，不具备一定技术实力、缺乏技术储备及行业经验的企业将无法适应市场的发展。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

(1) 电磁屏蔽膜

公司在全球电磁屏蔽膜领域具有重要的市场地位，全球市场占有率超过 20%，位居国内第一、全球第二。

(2) 极薄挠性覆铜板

公司自主研发生产的极薄挠性覆铜板，分为极薄三层挠性覆铜板和极薄两层挠性覆铜板，其铜层厚度、剥离强度等关键指标国际先进，具有优异的加工性能，且其下游客户与电磁屏蔽膜产品的客户重合度较高，利于市场开拓。

(3) 超薄铜箔

公司自主研发生产的超薄铜箔，其铜层厚度、剥离强度、抗拉强度等关键指标处于世界先进水平，且其下游客户与电磁屏蔽膜产品的客户重合度较高，利于市场开拓。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

(1) 电磁屏蔽膜

电子产品技术及应用的快速发展对电磁屏蔽膜的技术要求越来越高，FPC 趋于高频高速化，产生的电磁干扰越来越严重，有效抑制电磁干扰成为了 FPC 产品的重要性能要求。目前，FPC 电

磁屏蔽的主要措施是在其表面贴电磁屏蔽膜。因为 FPC 轻薄、可弯曲等特点，对电磁屏蔽膜也提出了很高的要求，除电磁屏蔽效能符合要求以外，还要具备轻薄、耐弯折、接地电阻低、高剥离强度以及更低插入损耗等特点。

5G 商用、汽车电子、高清显示等下游应用技术带动电磁屏蔽膜市场不断增大，为公司发展提供了更大空间。

(2) 极薄挠性覆铜板

挠性覆铜板领域主要显现出两大发展趋势：

第一，对极薄挠性覆铜板的需求不断增大。普通挠性覆铜板领域，技术成熟稳定，进入门槛相对较低，基本已达到充分竞争的市场状态。极薄挠性覆铜板，具备高尺寸安定性，是实现高互连密度技术的关键材料之一，是电子产品轻、薄、短、小、多功能、集成化方向发展重要材料之一。在极薄挠性覆铜板领域，我国的技术水平总体落后于日本，目前全球极薄挠性覆铜板市场主要被住友金属工业公司、东丽株式会社所占据。公司研发的极薄挠性覆铜板，可以显著提高剥离强度，在性能上已达到日本同类产品水平，公司是国内少数掌握极薄挠性覆铜板生产工艺的厂商之一。

第二，对二层法产品的需求不断增大。现阶段，我国挠性覆铜板大部分为三层法产品，其二层法产品较少。三层法产品多应用于 LED 灯条板等中低端电子产品，而高质量要求的智能电子终端产品应用较少。未来，随着行业技术的突破以及设备工艺水平的提升，我国无胶软板 FPC 基材（2-Layer FCCL）将得到更多的发展空间。根据 Mekttec 的市场预估，未来 5 年内，无胶软板 FPC 基材（2-Layer FCCL）将逐步取代三层有胶软板基材。国内 2L-FCCL 产品生产量较少，产量亦不足以供应高阶软板的需求，公司是国内极少数掌握高端 2L-FCCL 核心技术和设备制造工艺的厂商之一。

(3) 超薄铜箔

伴随着便携式电子产品的迅猛发展，印刷线路板向以高密度互连技术为主体的密、薄、平方向的发展，以及锂电池工业向着超薄和大容量两极发展，对其生产所需的原材料铜箔的要求也越来越高，使得铜箔产品向薄化、超薄化方向发展。公司的超薄铜箔厚度、剥离强度、抗拉强度等关键指标处于世界先进水平。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2019年	2018年	本年比上年 增减(%)	2017年
总资产	1,571,154,765.64	452,580,090.69	247.16	377,803,513.82
营业收入	291,693,846.84	274,707,377.26	6.18	226,254,503.03
归属于上市公司股东的净利润	128,658,027.01	117,155,272.31	9.82	96,291,050.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	104,017,585.00	111,923,253.21	-7.06	92,363,872.88
归属于上市公司股东的净资产	1,522,552,177.42	414,854,527.78	267.01	347,199,255.47
经营活动产生的现金流量净额	129,936,444.01	125,392,531.14	3.62	75,989,261.52
基本每股收益（元/股）	1.88	1.95	-3.59	1.60
稀释每股收益（元/股）	1.88	1.95	-3.59	1.60
加权平均净资产收益率（%）	14.50	31.08	减少16.58个百分点	32.20
研发投入占营业收入的比例（%）	11.63	7.88	增加3.75个百分点	8.59

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	58,903,035.99	80,161,994.80	91,919,487.59	60,709,328.46
归属于上市公司股东的净利润	25,268,527.19	38,710,575.98	41,158,398.01	23,520,525.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	24,297,415.00	32,356,750.79	39,218,178.68	8,145,240.53
经营活动产生的现金流量净额	30,340,081.92	10,932,693.26	36,887,854.43	51,775,814.40

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

4.1 股东持股情况

单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)								9,346
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)								7,601
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)								0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)								0
前十名股东持股情况								
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	包含转融 通借出股 份的限售 股份数量	质押或冻结 情况		股东 性质
						股份 状态	数量	
胡云连	0	14,555,802	18.19	14,555,802	14,555,802	无	0	境内 自然 人
广州力加电子有 限公司	0	14,086,260	17.61	14,086,260	14,086,260	无	0	境内 非国 有法 人
易红琼	0	7,512,672	9.39	7,512,672	7,512,672	无	0	境内 自然 人
广州美智电子有 限合伙企业(有限 合伙)	0	7,200,000	9.00	7,200,000	7,200,000	无	0	其他
苏州松禾成长二 号创业投资中心 (有限合伙)	0	5,845,800	7.31	5,845,800	5,845,800	无	0	其他
叶勇	0	2,695,420	3.37	2,695,420	2,695,420	无	0	境内 自然 人
李冬梅	0	2,347,710	2.93	2,347,710	2,347,710	无	0	境内 自然 人

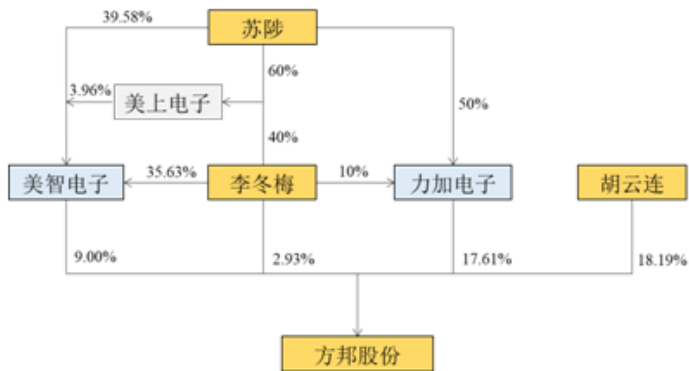
湖北小米长江产业投资基金管理有限公司—湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙)	0	2,000,000	2.50	2,000,000	2,000,000	无	0	其他
夏登峰	0	1,408,626	1.76	1,408,626	1,408,626	无	0	境内自然人
上海斐君投资管理中心(有限合伙)—广州黄埔斐君产业投资基金合伙企业(有限合伙)	0	1,200,000	1.50	1,200,000	1,200,000	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	胡云连、广州力加电子有限公司、广州美智电子有限合伙企业(有限合伙)、李冬梅是公司控股股东,合计持有公司 47.73%股份;苏陟、胡云连、李冬梅为公司实际控制人,其中苏陟与李冬梅为配偶关系,共同控制广州力加电子有限公司、广州美智电子有限合伙企业(有限合伙);夏登峰是公司监事会主席,股东易红琼与董事刘西山为配偶关系,股东叶勇与监事赵亚萍为配偶关系;除此之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用							

存托凭证持有人情况

适用 不适用

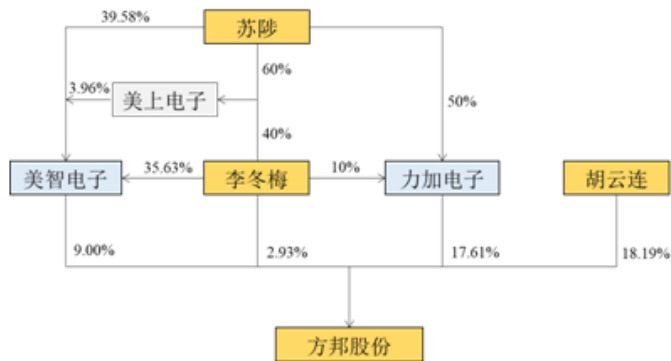
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司坚持以客户为中心，加强市场开拓力度：实现营业收入 291,693,846.84 元，较上年同期增长 6.18%；归属于母公司所有者的净利润 128,658,027.01 元，较上年同期增长 9.82%。

2 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

本公司根据财政部《关于修改印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。

公司自 2019 年 1 月 1 日期执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

详情请见本报告第十一节财务报告“五、重要会计政策及会计估计 44、重要会计政策和会计估计的变更”。

4 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

5 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

适用 不适用

公司将惠州力邦电子有限公司、东莞市惟实电子材料科技有限公司和珠海达创电子有限公司 3 家子公司纳入报告期合并财务报表范围,情况详见本财务报表“附注八、合并范围的变更”、本“附注九、在其他主体中的权益”。